

雙鍵 DB9221 單組分導熱矽脂



產品特點：

DB9221 具有極佳的導熱性，良好的電絕緣性和使用穩定性，粘度低及較好的使用穩定性，可以在-50℃～200℃間長期使用，完全符合歐盟 **ROHS** 指令要求。

優點：

A、導熱係數高，導熱係數達到 **1.2[W/(m·K)]**，這是評價導熱矽脂最重要的性能指標。

B、油離度低。**DB9221** 的油離度指標為：**200℃**，**8 小時**的條件下析油值≤**3.0 %**。

C、耐溫性好，在 **200℃** 條件下不固化，不流淌。

典型用途：

電子元器件的熱傳遞介質，如 **CPU** 與散熱器填隙，大功率三極管、可控矽元件二極體與基材（鋁、銅）接觸的縫隙處的填充，降低發熱元件的工作溫度。

技術參數：

序號	項目	DB9221
1	外觀	白色膏狀物
2	針入度 (1/10mm)	340~260
3	密 度 (g/cm ³)	2.2
4	油離度 (%, 200℃/8hr)	≤3.0
5	揮發度 (%, 200℃/8hr)	≤2.0
6	導 熱 系 數 [W/ (m • K)]	≥1.2

以上機械性能和電性能資料均在 25℃，相對濕度 55 % 固化 1 天后所測。

本公司對測試條件不同或產品改進造成的資料不同不承擔相關責任。

使用工藝：

清洗待塗覆表面，除去油污；然後將導熱矽脂直接擠出均勻的塗覆在待塗覆表面即可。注意施工表面應該均勻一致，只要塗敷薄薄一層即可。

注意事項：

導熱矽脂的使用不是塗的越多越好，而是在保證填滿間隙的前提下越薄越好。